

## BAREBONE XPC slim DH610S

### ROBUSTER 1,3-LITER SLIM PC UNTERSTÜTZT INTEL CORE PROZESSOREN MIT SOCKEL LGA1700 UND ZWEI UHD DISPLAYS

Das Shuttle XPC slim Barebone DH610S mit H610 Chipsatz bringt die Performance von Intels 12./13. und 14. Generation\*) der Core Desktop-Prozessoren (Codename "Alder Lake-S" und "Raptor Lake-S [Refresh]") mit Sockel LGA1700 ins kompakte 1,3-Liter Format. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von zwei Ultra HD Displays über HDMI und DisplayPort. Ebenfalls vorhanden sind Intel LAN-Funktion, acht USB-Ports sowie Audio-Ports. Sein flaches Metallgehäuse, die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und der zuverlässige Betrieb bei bis zu 50 °C Umgebungstemperatur machen das DH610S ideal für professionelle Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Digital Signage, POS, POI, Spielautomaten, Büro, Gesundheitswesen und Industrie.



#### SLIM DESIGN

- Flaches 1,35-Liter Metallgehäuse, schwarz
- Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH)
- Unterstützt 24/7 Dauerbetrieb
- Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)

#### BETRIEBSSYSTEM

- Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
- Unterstützt Windows 10, Windows 11 und Linux (64-Bit)

#### PROZESSOR SUPPORT \*\*)

- Sockel LGA1700 unterstützt Intel Core Prozessoren der 12./13./14. Generation "Alder Lake-S" und "Raptor Lake-S [Refresh]": Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold und Celeron, max. 65W TDP
- Heatpipe-Kühlsystem mit zwei Lüftern

#### GRAFIK

- Integrierte Intel HD-Grafik, unterstützt 4K (Eigenschaften hängen vom Prozessortyp ab)
- Unterstützt zwei unabhängige UHD-Displays

#### CHIPSATZ

- Intel H610 Chipsatz

#### SPEICHER SUPPORT

- 2x 260-Pin SO-DIMM-Steckplatz
- Unterstützt DDR4-3200/2666/2400
- max. 2x 32 GB

#### LAUFWERKE- SATA / M.2

- 1x 2,5"-Schacht für SATA-Festplatte oder SSD
- 1x M.2-2280M Steckplatz (unterstützt PCIe 3.0 x4 NVMe oder SATA)
- 1x M.2-2230E Steckplatz für optionales WLAN-Modul

#### ANSCHLÜSSE

- 1x HDMI 2.0b
- 1x DisplayPort 1.4
- optional: VGA
- 2x Audio (Mikrofon + Line-out)
- 4x USB 3.2 Gen1 (1x Typ-C)
- 4x USB 2.0
- 1x USB 2.0 intern
- RJ45 LAN-Port (Intel 1G)
- Anschluss für externen Power-Button
- "Always-On" Jumper

#### POWER SUPPLY

- Externes 120W/19V Netzteil

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

- WLAN Modul (WLN-M (ac)/WLN-M1 (ax))
- Standfuß (PS02)
- VGA-Anschluss (PVG01)
- Rackmount-Kit (PRM01)
- Kabel für externen Power Button (CXP01)
- Hutschienen-Montage-Kit (DIR01)
- LTE-Kit (WWN03)
- VESA-Halterung (PV04)



#### MODELLE DER DH6xx-SERIE

Produkt	Chip	HDMI	DP	Displays	LAN (Intel)	M.2-2280 Slot	COM	Cardreader	DC-In	VESA Mount	UPC Code
<b>DH610S</b>	H610	1	1	max. 2 *)	1G	PCIe v3.0 X4	—	—	19V	—	887993005126
<b>DH610</b>	H610	1	2	max. 3	1G+2.5G	PCIe v3.0 X4	2	—	12V + 19V	enthalten	887993005119
<b>DH670</b>	H670	2	2	max. 4	2x 1G	PCIe v4.0 X4	2	Ja	19V	enthalten	887993004983
<b>DH670V2</b>	H670	2	2	max. 4	2x 2.5G	PCIe v4.0 X4	2	—	19V	enthalten	887993005942

\*) max. 3 Displays mit dem optionalen VGA-Port (Zubehör PVG01)

\*\***Hinweis:** für Intel Core Prozessoren der 13./14. Generation (Raptor Lake-S [Refresh]) ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß. Generation 13 wird seit BIOS-Version 201 unterstützt (verfügbar seit März'23) und Generation 14 wird seit BIOS-Version 210 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

## LEISTUNGSMERKMALE



### Robust, stilvoll und sehr klein

Man muss es selbst in der Hand gehalten haben, um zu merken, wie klein es wirklich ist. Das Stahlblechgehäuse verleiht diesem Slim-PC die nötige Stabilität für professionelle Anwendungen wie z.B. Digital Signage. Obwohl das Gehäuse für die gebotene Systemleistung mit nur 1,35 Litern sehr klein ist, wirkt der Aufbau nicht gedrängt, so dass die Installation leicht von der Hand geht. Dank seiner schlichten, stilvollen Optik wird es auch mancher stolzer Besitzer in seinem Büro oder zu Hause einsetzen.



### Ein M.2-Slot für SSD-Karten

Der M.2-2280M Steckplatz unterstützt M.2 SSD Flashspeicherkarten mit NVMe/PCIe V3.0 X4- oder SATA-Schnittstelle. Verwendete M.2-Karten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.



### Intel Netzwerkfunktion

Das DH610S bietet einen Netzwerkanschluss mit Intel Netzwerk-Adapter - Intel ist bekannt für exzellente Performance und Treiber-Kompatibilität und wird daher in manchen professionellen Bereichen bevorzugt eingesetzt.



### Leise durch effizientes Heatpipe-Kühlsystem

Ein aktives Doppellüfter-Heatpipe-Kühlsystem gewährleistet größtmögliche Laufruhe und Systemstabilität.



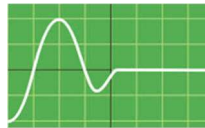
### VESA-Halter (optional)

Mit der optionalen 75/100mm-VESA-Halterung PV04 kann das DH610S an einer Wand, an einer Armhalterung oder hinter einem Monitor montiert werden, was speziell in Industrie, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen gefragt ist. Zahlreiche M3-Gewindeöffnungen im Gehäuse des PCs ermöglichen außerdem die Montage an nahezu beliebigen Orten.



### Erweiterter Temperaturbereich und für Dauerbetrieb geeignet

Das Shuttle XPC slim Barebone DH610S ist offiziell für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und des fortschrittlichen Kühlsystems ist dieser PC besonders zuverlässig. Das eignet ihn ideal für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen - auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C (nicht kondensierend). **Achtung:** Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke empfohlen.



### Einschalten nach Stromausfall

Die "Power-On after Power Fail"-Funktion im BIOS-Setup definiert, wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen (3) ausgeschaltet lassen (4) Einschalten über Netzwerk oder (5) Einschalten über Echtzeituhr (RTC). Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH610S zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2, dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.



### Unterstützt Sockel LGA1700 Intel® Core™ Prozessoren \*)

"Alder Lake-S" und „Raptor Lake-S (Refresh)" sind die Codenamen von Intels 12./13./14. Generation der Intel® Core™ Prozessoren mit Sockel LGA1700, die zusammen mit der 600/700er-Chipsatzserie vorgestellt wurden. Intel Prozessoren der 12000/13000/14000er Serie bieten ein Hybrid-Design mit einer bestimmten Anzahl von P-Kernen (hohe Performance) und E-Kernen (hohe Effizienz). Ob für Gamer, Kreative, Streamer oder alltägliche Benutzer - jetzt steht mehr Leistung dort zur Verfügung wo sie gebraucht wird.

\*) ein BIOS-Update könnte erforderlich sein, um Gen13/14 zu unterstützen



### Externer Power-Button per Remoteleitung

Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten (z. B. einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs. (Rastermaß: 2.54 mm). Außerdem stellt dieser Anschluss eine Clear CMOS Funktion bereit und liefert eine +5V DC Spannung für externe Geräte.

+5V voltage (2) (4) Power Button  
Clear CMOS (1) (3) Ground



### Unterstützt zwei UHD-Displays

Das DH610S bietet zwei digitale Video-Ausgänge: ein HDMI 2.0b und einen DisplayPort (DP 1.4), die beide ein 4K-Display mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung (2160p) und 60Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen. Zusätzlich ist ein optionaler VGA-Ausgang möglich, womit max. drei Displays gleichzeitig unterstützt werden.

## Vorder- und Rückansicht

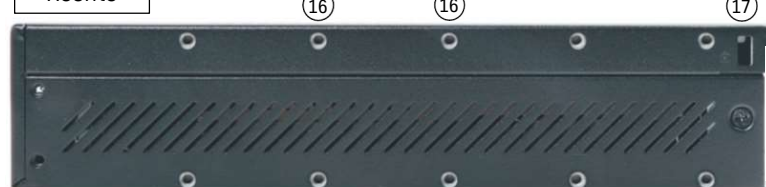
Vorderseite



Rückseite



Rechts



Links

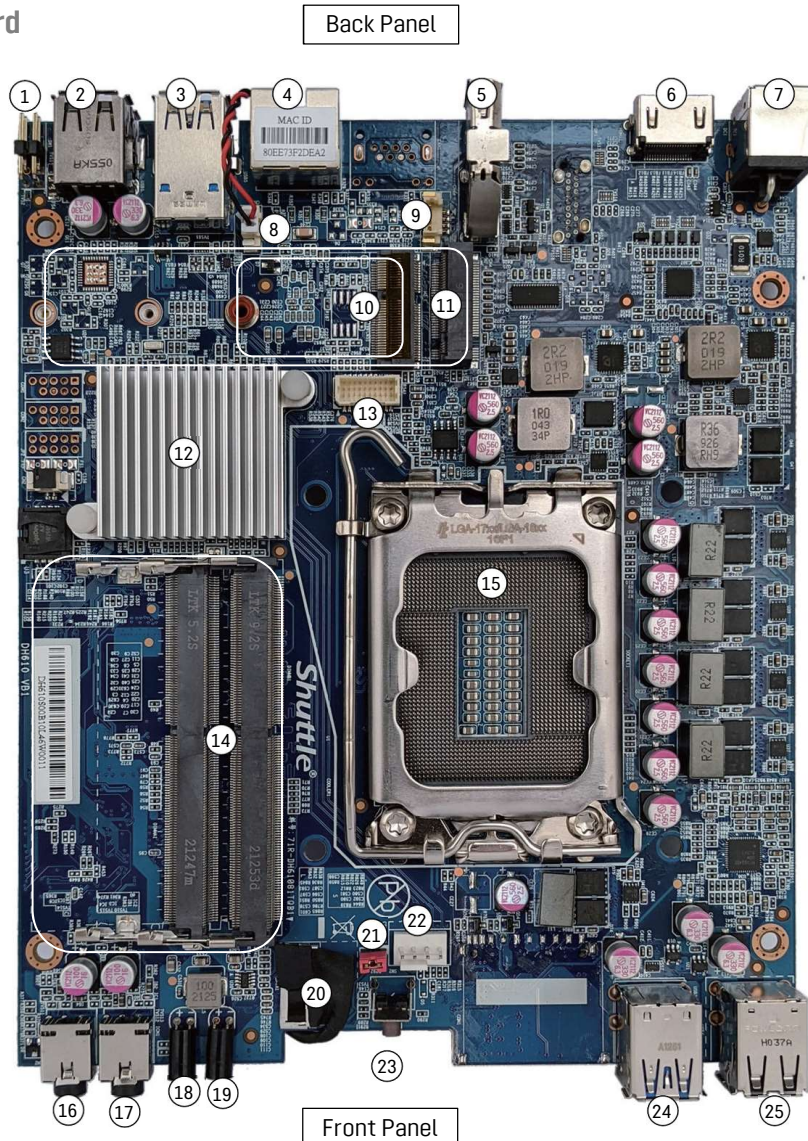


1. Mikrofon-Eingang
2. Kopfhörer-Ausgang
3. Betriebsanzeige-LED
4. Festplatten/SSD-LED
5. Ein-/Ausschalt-Button
6. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C)
7. 2x USB 2.0
8. 2x WLAN Perforation
9. DC-Anschluss für das externe Netzteil
10. HDMI 2.0b Port
11. DisplayPort 1.4
12. RJ45 Gigabit LAN Port
13. 2x USB 3.2 Gen 1 Port
14. 2x USB 2.0
15. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß)

16. Löcher mit M3-Gewinde
17. 2x Öffnung für das Kensington-Lock

18. VESA-Halterung (zwei Teile)

## Mainboard



Back Panel

Rückseite



Vorderseite



Front Panel

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4-Pin-Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC-Spannung (2,54 mm Rastermaß)</li> <li>2. 2x USB 2.0 Port</li> <li>3. 2x USB 3.2 Gen 1 Port (1x Typ-C)</li> <li>4. RJ45 Gigabit LAN Port</li> <li>5. DisplayPort 1.4</li> <li>6. HDMI 2.0b Port</li> <li>7. DC-Anschluss für externes Netzteil</li> <li>8. Anschluss für CMOS-Batterie</li> <li>9. Onboard USB-2.0-Anschluss (4-Pin)</li> <li>10. M.2-2230E Steckplatz für WLAN-Karte</li> <li>11. M.2-2280M Steckplatz für SSD-Karte</li> <li>12. Intel H610 Chipsatz mit Kühlkörper</li> <li>13. Onboard VGA Anschluss</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. 2x S0-DIMM Speichersteckplatz</li> <li>15. LGA1700 Prozessorsocket</li> <li>16. Mikrofon-Eingang</li> <li>17. Audio Line-Out / Kopfhörer-Ausgang</li> <li>18. Betriebsanzeige-LED</li> <li>19. Festplatten/SSD-LED</li> <li>20. SATA v3.0 Anschluss</li> <li>21. Always-Power-On Jumper</li> <li>22. 4-Pin Anschluss für den Prozessorlüfter</li> <li>23. Ein-/Ausschalt-Button</li> <li>24. 2x USB 3.2 Gen 1 Port</li> <li>25. 2x USB 2.0 Port</li> </ol> |
|--|---|

## BENÖTIGTE KOMPONENTEN

Es werden nur wenige Komponenten benötigt, um einen lauffähigen Mini-PC zu erhalten:

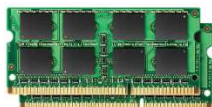
### Shuttle XPC slim Barebone DH610S



#### LGA1700 Prozessor

Intel Core Gen 12/13/14 "Alder Lake-S" oder "Raptor Lake-S [Refresh]" Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold oder Celeron TDP max. 65 W

**\*)** ein BIOS-Update könnte erforderlich sein, um Gen13/14 zu unterstützen



#### Speichermodule

Ein oder zwei Speichermodule:  
DDR4-3200/2666/2400 SO-DIMM  
jeweils max. 32 GB



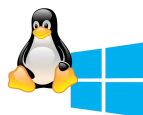
#### 2,5" Laufwerk

Festplatte oder SSD im 2,5"-Format  
(max. Bauhöhe: 12,5 mm)



#### M.2 SSD (optional)

M.2-2280/2260/2242  
SSD-Modul (SATA or PCIe/NVMe)



#### Betriebssystem

Windows 10/11 oder Linux (nur 64-Bit)

## OPTIONALES ZUBEHÖR VON SHUTTLE



#### VGA-Port-Adapter **PVG01**

Der Einbau von PVG01 ersetzt eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel.



#### Standfuß **PS02**

für den vertikalen Betrieb



#### WLAN-Kit

**WLN-M** (802.11ac / Wifi 5)

**WLN-M1** (802.11ax / Wifi 6)

Die M.2-2230-Karte unterstützt WLAN und Bluetooth  
Enthält 2 Antennen



#### Hutschienen-Kit **DIR01**

ermöglicht die Montage auf einer Standard 35-mm-Hutschiene



#### LTE Adapter Kit **WWN03**

ermöglicht die Installation einer M.2-LTE-Karte und einer nano SIM Karte (dabei wird der 2,5"-Schacht belegt)



#### Rackmount-Kit **PRM01**

2HE-Blende für Einbau von zwei 1,3L-Shuttle-XPCs in einen 19" Schrank



#### Kabel **CXP01**

Anschlusskabel für einen externen Power-Button (ohne Button)



#### VESA-Halterung **PV04**

unterstützt den 75/100 mm VESA-Standard

## Produktvergleich: 4xx-Serie versus 6xx-Serie

MODELL	DH410S	DH410(C)	DH470(C)	DH610S	DH610	DH670(V2)
PROZESSOR SUPPORT	Intel Core, Socket LGA1200, TDP max. 65 W Codename "Comet Lake-S" – Gen 10			Intel Core, Socket LGA1700, TDP max. 65 W Codename "Alder Lake-S"/"Raptor Lake-S" – Gen 12/13/14 **)		
CHIPSATZ	Intel H410	Intel H410	Intel H470	Intel H610	Intel H610	Intel H670
BETRIEBSSYSTEM	Windows 10/11 und Linux (64-Bit)			Windows 10/11 und Linux (64-Bit)		
MULTI-DISPLAY	max. 2	max. 2	max. 3	max. 2 **)	max. 3	max. 4
RAM-SPEICHER	max. 2x 32 GB DDR4-2933/2666 SO-DIMM			max. 2x 32 GB <b>DDR4-3200</b> /2666 SO-DIMM		
2,5"-SCHACHT	1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm			1x 2,5" Laufwerksschacht, SATA-Anschluss max. Laufwerkshöhe: 12,5 mm		
M.2-2280 SSD SLOT	M.22280M unterstützt PCIe 3.0 x4 oder SATA			PCIe 3.0 x4 oder SATA	PCIe 3.0 x4 oder SATA	<b>PCIe 4.0</b> x4 oder SATA
WLAN SLOT	M.2-2230E			M.2-2230E		
BUTTONS / LEDS	Power-Button, Power LED, HDD LED			Power-Button, Power LED, HDD LED		
SD CARDREADER	Ja, jedoch nicht bei DH410C und DH470C			Nein	Nein	Ja, <b>nur DH670</b>
GRAFIKPORTS	HDMI 1.4b DP 1.2	HDMI 2.0a DP 1.2	HDMI 2.0a <b>2x DP 1.2</b>	HDMI 2.0b DP 1.4	HDMI 2.0b <b>2x DP 1.4</b>	<b>2x HDMI 2.0b</b> <b>2x DP 1.4</b>
USB 3.2 GEN. 2	–	–	<b>4</b>	–	–	<b>4</b>
USB 3.2 GEN. 1	4 (1x Typ-C)	4	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)
USB 2.0	4	4	–	4	4	–
COM PORTS	–	2	2	–	2	2
GIGABIT NETZWERK	Single LAN Realtek 8111H (1G)	Dual LAN 2x Intel 210 (1G)	Dual LAN 2x Intel 210 (1G)	Single LAN <b>Intel 219V/LM (1G)</b>	Dual LAN <b>Intel 225 (2.5G)</b> <b>Intel 219V/LM (1G)</b>	Dual LAN <b>2x i210/211 (1G)</b> <b>DH670V2: 2x 2.5G</b>
AUDIO	Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662)			Mikrofon-Eingang, Line-Out (Realtek ALC662/897/888S)		
OPTIONALES ZUBEHÖR	WLAN-Kit: <b>WLN-M/WLN-M1</b> Standfuß: <b>PS02</b> , VGA-Port-Adapter: <b>PVG01</b> Power Button Kabel: <b>CXP01</b> Rackmount-Kit: <b>PRM01</b> , Hutschienen-Kit: <b>DIR01</b> LTE-Kit: <b>WWN03</b>			WLAN-Kit: <b>WLN-M/WLN-M1</b> Standfuß: <b>PS02</b> , VGA-Port-Adapter: <b>PVG01</b> Power Button Kabel: <b>CXP01</b> Rackmount-Kit: <b>PRM01</b> , Hutschienen-Kit: <b>DIR01</b> LTE-Kit: <b>WWN03</b>		
VESA-HALTER	optional <b>PV04</b>	mitgeliefert	mitgeliefert	optional <b>PV04</b>	mitgeliefert	mitgeliefert
NETZTEIL	90 W / 19 V			<b>120 W / 19 V</b>		
DC-IN 12V SUPPORT	–	<b>Ja</b>	–	–	<b>Ja</b>	–

### Produktbilder



\*) DH410C und DH470C haben keinen Cardreader eingebaut. \*\*) DH610S unterstützt drei Displays, falls ein VGA-Port eingebaut wird (Zubehör PVG01)

\*\*) Wichtiger Hinweis für Shuttle XPCs der DH6xx/XH61x-Serie: für Intel Core Prozessoren der 13./14. Generation (Raptor Lake-S [Refresh]) ist möglicherweise ein BIOS-Update erforderlich, das zuvor mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

## SHUTTLE XPC SLIM BAREBONE DH610S – SPEZIFIKATION

GEHÄUSE	<p>Slim PC mit schwarzem Metallgehäuse</p> <p>Abmessungen: 19 x 16,5 x 4,3 cm (LBH) = 1,35 Liter</p> <p>Gewicht: 1,3 kg netto und 2,1 kg brutto</p> <p>Zwei Öffnungen für Kensington Lock und zahlreiche M3-Gewindeöffnungen an beiden Gehäuseseiten.</p>
NETZTEIL	<p>Externes 120 W Netzteil (lüfterlos)</p> <p>Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz</p> <p>Ausgang: 19 V DC, 6,32 A, max. 120 W</p> <p>DC-Stecker: 5,5/2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser)</p> <p>Hinweis: Der DC-Eingang des Computers unterstützt eine externe Spannungsversorgung mit 19V±5%</p> <p>AC-Kabel: 3-polig, ca. 1,7 m lang, mit C5/C6 Kleeblatt-Steckverbindung zum Netzteil und CEE-7/7 Stecker mit Schutzkontakt (Typ E+F) für den Anschluss an die Steckdose</p>
BETRIEBSSYSTEM	<p>Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.</p> <p>Es ist kompatibel mit Windows 10/11 und Linux (64 Bit).</p>
PROZESSOR-UNTERSTÜTZUNG	<p>Prozessor Socket LGA1700</p> <p>Unterstützt Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold und Celeron Prozessoren</p> <p>Unterstützt folgende Generationen Intel Core Prozessoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gen 12 "Alder Lake-S"</li> <li>- Gen 13 "Raptor Lake-S" seit BIOS-Version 201 verfügbar seit März'23 *)</li> <li>- Gen 14 "Raptor Lake-S Refresh" seit BIOS-Version 210 verfügbar seit Jan'24 *)</li> </ul> <p>in "Intel 7" Prozesstechnologie (ehemals: Intel 10 nm Enhanced SuperFin)</p> <p>Unterstützt nur Prozessoren mit integrierter Grafikkfunktion [5]</p> <p>Maximal unterstützte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 65 W.</p> <p>Unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.</p> <p>Der Prozessor integriert die Controller für PCI-Express und Speicher und die Grafikkfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip</p> <p><b>*) Achtung:</b> falls ein BIOS-Update notwendig ist, dann muß der PC zunächst mit einem kompatiblen Prozessor gestartet werden.</p> <p>Download-Website: <a href="https://global.shuttle.com/support/download">https://global.shuttle.com/support/download</a></p>
PROZESSOR-KÜHLUNG	<p>Heatpipe-Prozessor-Kühlung mit zwei 60-mm-Lüftern auf der Gehäuseoberseite</p>
MAINBOARD / CHIPSATZ	<p>Mainboard im Shuttle-Format - spezielles Design für XPC Barebone DH610S</p> <p>Chipsatz/Southbridge: Intel® H610</p> <p>Passive Chipsatz-Kühlung mit Kühlkörper</p> <p>Die Northbridge ist im Prozessor integriert.</p> <p>Mit Feststoffelektrolytkondensatoren (Solid Capacitors) - diese Kondensatoren sind hitzebeständiger und langlebiger.</p>
BIOS	<p>AMI BIOS, SPI-Interface, 16 MB Flash-EEPROM-Baustein</p> <p>Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion</p> <p>Unterstützt Firmware-TPM (fTPM) v2.0 [3]</p> <p>Unterstützt Booten vom externem Flashspeicher über USB</p> <p>Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)</p> <p>Unterstützt Neustart nach Stromausfall (Power-On-after-Power-Fail) [7]</p>
SPEICHER-UNTERSTÜTZUNG	<p>2x SO-DIMM-Steckplatz mit 260 Pins</p> <p>Unterstützt DDR4-3200/2933/2666/2400/2133 (PC4-25600/23466/21300/19200/17000) SDRAM mit 1,2 V</p> <p>Unterstützt Dual-Channel-Modus</p> <p>Unterstützt maximal 32 GB pro Steckplatz</p> <p>Gesamtkapazität maximal 64 GB</p> <p>Unterstützt unbuffered DIMM-Module (kein ECC oder registered)</p>
INTEGRIERTE GRAFIKFUNKTION	<p>Die Eigenschaften der integrierten Intel UHD Grafikkfunktion hängen vom verwendeten Prozessortyp ab. [5]</p> <p>Der PC bietet zwei digitale Video-Ausgänge, die 1080p/60 und 2160p/60 unterstützen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x HDMI v2.0b</li> <li>- 1x DisplayPort v1.4</li> </ul> <p>Unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung</p> <p>DisplayPort und HDMI unterstützen Multikanal Digital Audio über das gleiche Kabel.</p> <p>Optional analoger D-Sub/VGA-Videoausgang [4]</p> <p>Unterstützt zwei unabhängige Displays über die integrierte Grafikkfunktion (mit dem optionalen VGA-Ausgang sogar drei Display)</p>

<b>LAUFWERKSSCHACHT</b>	1x 6,35 cm / 2,5" Laufwerksschacht für eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk mit SATA-Anschluss Laufwerkshöhe 12,5 mm (max.)
<b>SATA-ANSCHLUSS</b>	1x Serial-ATA III, 6 Gb/s (600 MB/s) Datentransferrate Mit Serial-ATA Stromanschluss (onboard)
<b>M.2-2280M SSD -STECKPLATZ</b>	Der M.2 2280M Steckplatz bietet folgende Schnittstellen: - PCI-Express Gen. 3.0 X4 unterstützt NVMe - SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s) Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben. Unterstützt M.2 SSDs mit SATA- oder PCI-Express-Schnittstelle
<b>M.2-2230E- STECKPLATZ FÜR WLAN-KARTEN</b>	Schnittstellen: PCI-Express Gen. 2.0 X1 und USB 2.0 Verwendete M.2-2230-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230) Unterstützt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehör: WLN-M, WLN-M1)
<b>SOUNDFUNKTION</b>	Audio Realtek® ALC 897/662/888S High-Definition Audio Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Vorderseite: 1) 2-Kanal Line-out (Kopfhörer) 2) Mikrofon-Eingang Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI und DisplayPort
<b>NETZWERK- CONTROLLER</b>	RJ45 Netzwerkanschluss mit zwei Status-LEDs Intel 219V/LM LAN-Controller unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate PCIe-Schnittstelle Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)
<b>ANSCHLÜSSE VORDERSEITE</b>	Anschlüsse Vorderseite Mikrofon-Eingang Audio Line-out (Kopfhörer) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C 2x USB 2.0 Typ A (Schwarz) Ein/Aus-Button Betriebsanzeige-LED (Blau) Festplatten-LED (Gelb)
<b>ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE</b>	1x HDMI 2.0b Anschluss [1] 1x DisplayPort 1.4 Anschluss (DP) [2] Optional: 1x D-Sub VGA Anschluss (Zubehör PVG01 [4]) 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A (Blau) 2x USB 2.0 Typ A (Schwarz) 1x RJ45 Gigabit LAN Port 1x DC-Eingang für externes Netzteil (unterstützt 19V±5%) 1x 4-Pin-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) unterstützt: - externen Einschalt-Taster - Clear CMOS Funktion - 5V DC Spannung für externe Komponenten 2x Perforation für optionale Wireless-LAN-Antennen 2x Öffnung für Kensington Lock
<b>WEITERE ONBOARD- ANSCHLÜSSE</b>	1x Jumper für Power-On-after-Power-Fail (Hardware-Lösung) [7] 1x analoger VGA Grafikausgang CN6 (2x10 Pins, 1 mm Pitch) [4] 1x USB 2.0 (4 Pins) für optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit) 1x Lüfteranschluss (4 Pins) belegt durch das Kühlsystem 1x Anschluss für CMOS-Batterie (belegt)
<b>LIEFERUMFANG</b>	Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC) Vier Schrauben M3 x 4 mm (zur Montage eines 2,5"-Laufwerks) Zwei Schrauben M3 x 5 mm (silberfarben, zum Befestigen von zwei M.2-Karten) Treiber-DVD (Windows 64 Bit) Serial-ATA-Kabel für 2,5"-Laufwerk mit Stromanschluss Externes 120W-Netzteil mit Netzanschlusskabel Schutzkappe für den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kühler installiert sind) Wärmeleitpaste



OPTIONALES ZUBEHÖR	<p><b>PVG01:</b> Optionaler D-Sub VGA Video-Ausgang [4]</p> <p><b>WLN-M/M1:</b> WLAN-Modul im M.2-2230-Format mit zwei externen Antennen unterstützt WLAN und Bluetooth</p> <p><b>WWN03:</b> LTE-Adapter-Kit mit Antennen, jedoch ohne LTE-Karte [8]</p> <p><b>PS02:</b> Standfüße für den vertikalen Betrieb</p> <p><b>CXP01:</b> Adapterkabel für einen externen Power-Button</p> <p><b>PRM01:</b> 2HE-Rackblende für zwei Shuttle XPC slim PCs</p> <p><b>DIR01:</b> Hutschienen-Montage-Kit</p> <p><b>PV04:</b> VESA-Halterung</p>
UMGEBUNGS-PARAMETER	<p>Zulässiger Betriebstemperaturbereich: 0-50 °C [6]</p> <p>Relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend: 10-90 %</p>
ZERTIFIKATE / KONFORMITÄT	<p>EMI: FCC, CE, BSMI, RCM, VCCI</p> <p>Sicherheit: CB, BSMI, ETL</p> <p>Weitere: RoHS, Energy Star, ErP</p>
KONFORMITÄT	<p>Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:</p> <p>(1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)</p> <p>(2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD)</p> <p>(3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)</p>

**[1] HDMI-Ausgang** unterstützt DVI mit optionalem Adapter

**[2] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren**

Der DisplayPort Ausgang kann mit einem günstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1 m, DisplayPort (männl., 20P) zu HDMI-A (männl., 19P)

DELOCK 82435: 5 m, DisplayPort (männl., 20P) zu DVI-D (männl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht über einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

**[3] TPM-Funktion**

Dieses Produkt verfügt bereits über ein Firmware-TPM (fTPM) v2.0. Es ist außerdem für einen Hardware-TPM-Chip vorbereitet, so dass es auf Sonderbestellung im Werk bestückt werden kann.

**[4] Optionaler D-Sub/VGA-Ausgang**

Das Mainboard verfügt über einen analogen Grafikausgang CN6 auf dem Mainboard. Dieser kann über einen optionalen Adapter (PVG01) als 15-poliger D-Sub-Anschluss nach außen geführt werden. Hierbei wird eine serielle Schnittstelle (COM-Port) im Backpanel ersetzt. Die integrierte Grafik unterstützt maximal vier Displays gleichzeitig.

**[5] Nicht kompatibel sind Intel Prozessoren ohne integrierte Grafikfunktion** erkennbar an dem Buchstaben "F" in der Prozessorbezeichnung, z.B. Core i7-12700F.

**[6] Betriebstemperatur**

Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40 °C werden SSD-Laufwerke (bis zu 70 °C) und SO-DIMM-Speicher mit erweitertem Temperaturbereich (bis zu 95 °C) empfohlen.

**[7] Power-On-after-Power-Fail**

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On-after-Power-Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert: (1) unbedingt einschalten, (2) Status vor dem Stromausfall wiederherstellen oder (3) ausgeschaltet lassen. Prinzipbedingt kann diese Funktion jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass das DH610S zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man Jumper JP2 (auf dem Mainboard hinter dem Einschalt-Button), dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

**[8] Optionales Zubehör WWN03 (LTE-Kit)**

Mit Hilfe des Shuttle XPC accessory WWN03 Zubehör-Kits können Sie diesen PC mit einer LTE/4G-Funktion für mobiles Netzwerk ausstatten. Hierbei wird der 2,5"-Schacht für den Einbau der LTE-Karte belegt, so dass als Massenspeicher eine SSD im M.2-Format notwendig ist. Ein LTE-Modul im M.2-3042-Format und eine Nano-SIM-Karte sind weiterhin erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

**[9] Intel Core Prozessoren der 13. Generation "Raptor Lake-S"** unterstützt der Shuttle XPC DH610S ab der Firmware/BIOS-Version DH610100.201, die seit März 2023 verfügbar ist. Im Handel befindliche Shuttle XPCs haben in der Übergangsphase noch eine ältere Firmware/BIOS-Version und müssen zunächst mit Hilfe eines Gen-12-Prozessors "Alder Lake-S" upgedated werden.

## 12. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1700 10 nm "Alder Lake S" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2022)

Prozessoren mit TDP > 65 W und Prozessoren ohne Grafikfunktion ("F"-Kennung) werden **nicht unterstützt** (rot hinterlegt)

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	<b>12900K</b>	8 / 16	3,2 – 5,1 GHz	8	2,4 – 3,9 GHz	30 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	<b>12900KF</b>	8 / 16	3,2 – 5,1 GHz	8	2,4 – 3,9 GHz	30 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12900</b>	8 / 16	2,4 – 5,0 GHz	8	1,8 – 3,8 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
	<b>12900F</b>	8 / 16	2,4 – 5,0 GHz	8	1,8 – 3,8 GHz	30 MB	<b>65 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12900T</b>	8 / 16	1,4 – 4,8 GHz	8	1,0 – 3,6 GHz	30 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.55 GHz)
Core™ i7	<b>12700K</b>	8 / 16	3,6 – 4,9 GHz	4	2,7 – 3,8 GHz	25 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
	<b>12700KF</b>	8 / 16	3,6 – 4,9 GHz	4	2,7 – 3,8 GHz	25 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12700</b>	8 / 16	2,1 – 4,9 GHz	4	1,6 – 3,6 GHz	25 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
	<b>12700F</b>	8 / 16	2,1 – 4,9 GHz	4	1,6 – 3,6 GHz	25 MB	<b>65 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12700T</b>	8 / 16	1,4 – 4,6 GHz	4	1,0 – 3,4 GHz	25 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.50 GHz)
Core™ i5	<b>12600K</b>	6 / 12	3,7 – 4,9 GHz	4	2,8 – 3,6 GHz	20 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	<b>12600KF</b>	6 / 12	3,7 – 4,9 GHz	4	2,8 – 3,6 GHz	20 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12600</b>	6 / 12	3,3 – 4,8 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	<b>12600T</b>	6 / 12	2,1 – 4,6 GHz	-	-	18 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	<b>12500</b>	6 / 12	3,0 – 4,6 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	<b>12500T</b>	6 / 12	2,0 – 4,4 GHz	-	-	18 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1.45 GHz)
	<b>12400</b>	6 / 12	2,5 – 4,4 GHz	-	-	18 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	<b>12400F</b>	6 / 12	2,5 – 4,4 GHz	-	-	18 MB	<b>65 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12400T</b>	6 / 12	1,8 – 4,2 GHz	-	-	18 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
Core™ i3	<b>12300</b>	4 / 8	3,5 – 4,4 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	<b>12300T</b>	4 / 8	2,3 – 4,2 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	<b>12100</b>	4 / 8	3,3 – 4,3 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.45 GHz)
	<b>12100F</b>	4 / 8	3,3 – 4,3 GHz	-	-	12 MB	<b>58 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>12100T</b>	4 / 8	2,2 – 4,1 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1.40 GHz)
Pentium® Gold	<b>G7400</b>	2 / 4	3,7 GHz	-	-	6 MB	46 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.35 GHz)
	<b>G7400T</b>	2 / 4	3,1 GHz	-	-	6 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.35 GHz)
Celeron®	<b>G6900</b>	2 / 2	3,4 GHz	-	-	4 MB	46 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.30 GHz)
	<b>G6900T</b>	2 / 2	2,8 GHz	-	-	4 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 710 (1.30 GHz)

**K** = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, **T** = stromsparend, **F** = ohne integrierte Grafikfunktion, **TDP** = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH610S unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter [global.shuttle.com](http://global.shuttle.com).

## 13. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1700 10 nm Intel 7 / 10 nm, "Raptor Lake S" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2023)

Prozessoren mit **TDP>65 W** und **Prozessoren ohne Grafikkfunktion ("F"-Kennung)** werden **nicht unterstützt (rot hinterlegt)**

**Wichtiger Hinweis:** für Intel Core Prozessoren der 13. Generation ("Raptor Lake-S") und der 14. Generation ("Raptor Lake-S Refresh") ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

- Generation 13 wird seit BIOS-Version 201 unterstützt (verfügbar seit März'23) und

- Generation 14 wird seit BIOS-Version 210 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

Download-Website: <https://global.shuttle.com/support/download>.

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	<b>13900K</b>	8 / 16	3,2 – 6,0 GHz	16	2,4 – 4,3 GHz	36 MB	<b>150 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	<b>13900K</b>	8 / 16	3,0 – 5,8 GHz	16	2,0 – 4,3 GHz	36 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	<b>13900KF</b>	8 / 16	3,0 – 5,8 GHz	16	2,0 – 4,3 GHz	36 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>13900</b>	8 / 16	2,0 – 5,2 GHz	16	1,5 – 4,2 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	<b>13900F</b>	8 / 16	2,0 – 5,2 GHz	16	1,5 – 4,2 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>13900T</b>	8 / 16	1,1 – 5,1 GHz	16	0,8 – 3,9 GHz	36 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
Core™ i7	<b>13700K</b>	8 / 16	3,4 – 5,4 GHz	8	2,5 – 4,2 GHz	30 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
	<b>13700KF</b>	8 / 16	3,4 – 5,4 GHz	8	2,5 – 4,2 GHz	30 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>13700</b>	8 / 16	2,1 – 5,1 GHz	8	1,5 – 4,1 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
	<b>13700F</b>	8 / 16	2,1 – 5,1 GHz	8	1,5 – 4,1 GHz	30 MB	65 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>13700T</b>	8 / 16	1,4 – 4,8 GHz	8	1,0 – 3,6 GHz	30 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
Core™ i5	<b>13600K</b>	6 / 12	3,5 – 5,1 GHz	8	2,6 – 3,9 GHz	20 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,50 GHz)
	<b>13600KF</b>	6 / 12	3,5 – 5,1 GHz	8	2,6 – 3,9 GHz	20 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>13600</b>	6 / 12	2,7 – 5,0 GHz	8	2,0 – 3,7 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>13600T</b>	6 / 12	1,8 – 4,8 GHz	8	1,3 – 3,4 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>13500</b>	6 / 12	2,5 – 4,8 GHz	8	1,8 – 3,5 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>13500T</b>	6 / 12	1,6 – 4,6 GHz	8	1,2 – 3,2 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>13400</b>	6 / 12	2,5 – 4,6 GHz	4	1,8 – 3,3 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,55 GHz)
	<b>13400F</b>	6 / 12	2,5 – 4,6 GHz	4	1,8 – 3,3 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
Core™ i3	<b>13100</b>	4 / 8	3,4 – 4,5 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,50 GHz)
	<b>13100F</b>	4 / 8	3,4 – 4,5 GHz	-	-	12 MB	58 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>13100T</b>	4 / 8	2,5 – 4,2 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,50 GHz)

**K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, T = stromsparend, F = ohne integrierte Grafikkfunktion, TDP = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).**

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH610S unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter [global.shuttle.com](https://global.shuttle.com).

## 14. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1700 10 nm Intel 7 / 10 nm, "Raptor Lake S Refresh" Prozessorübersicht (Datum: Januar 2024)

Prozessoren mit **TDP>65 W** und **Prozessoren ohne Grafikkfunktion ("F"-Kennung)** werden **nicht unterstützt (rot markiert)**

**Wichtiger Hinweis:** für Intel Core Prozessoren der 13. Generation ("Raptor Lake-S") und der 14. Generation ("Raptor Lake-S Refresh") ist eventuell ein BIOS-Update notwendig, das mit einem kompatiblen Prozessor durchgeführt werden muß.

- Generation 13 wird seit BIOS-Version 201 unterstützt (verfügbar seit März'23) und

- Generation 14 wird seit BIOS-Version 210 unterstützt (verfügbar seit Jan'24).

Download-Website: <https://global.shuttle.com/support/download>.

PROZESSOR	MODELL	P-CORES/ THREADS	P-CORES TAKT/Turbo	E-CORES	E-CORES TAKT/Turbo	SMART CACHE	BASE TDP	SPEICHER SUPPORT	GRAFIKFUNKTION (MAX. TAKT)
Core™ i9	<b>14900K</b>	8 / 16	3,2 – 5,6 GHz	16	2,4 – 4,4 GHz	36 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	<b>14900KF</b>	8 / 16	3,2 – 5,6 GHz	16	2,4 – 4,4 GHz	36 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14900</b>	8 / 16	2,0 – 5,4 GHz	16	1,5 – 4,3 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
	<b>14900F</b>	8 / 16	2,0 – 5,4 GHz	16	1,5 – 4,3 GHz	36 MB	65 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14900T</b>	8 / 16	1,1 – 5,1 GHz	16	0,8 – 4,0 GHz	36 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,65 GHz)
Core™ i7	<b>14700K</b>	8 / 16	3,4 – 5,6 GHz	8	2,5 – 4,3 GHz	33 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
	<b>14700KF</b>	8 / 16	3,4 – 5,6 GHz	8	2,5 – 4,3 GHz	33 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14700</b>	8 / 16	2,1 – 5,3 GHz	8	1,5 – 4,2 GHz	33 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
	<b>14700F</b>	8 / 16	2,1 – 5,4 GHz	8	1,5 – 4,2 GHz	33 MB	65 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14700T</b>	8 / 16	1,3 – 5,0 GHz	8	0,9 – 3,7 GHz	33 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,60 GHz)
Core™ i5	<b>14600K</b>	6 / 12	3,5 – 5,3 GHz	8	2,6 – 4,0 GHz	24 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	UHD 770 (1,50 GHz)
	<b>14600KF</b>	6 / 12	3,5 – 5,3 GHz	8	2,6 – 4,0 GHz	24 MB	<b>125 W</b>	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14600</b>	6 / 12	2,7 – 5,2 GHz	8	2,0 – 3,9 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>14600T</b>	6 / 12	1,8 – 5,1 GHz	8	1,3 – 3,6 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>14500</b>	6 / 12	2,6 – 5,0 GHz	8	1,9 – 3,7 GHz	24 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>14500T</b>	6 / 12	1,7 – 4,8 GHz	8	1,2 – 3,4 GHz	24 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 770 (1,55 GHz)
	<b>14400</b>	6 / 12	2,5 – 4,7 GHz	4	1,8 – 3,5 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,55 GHz)
	<b>14400F</b>	6 / 12	2,5 – 4,7 GHz	4	1,8 – 3,5 GHz	20 MB	65 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14400T</b>	6 / 12	1,5 – 4,5 GHz	4	1,1 – 3,2 GHz	20 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,55 GHz)
Core™ i3	<b>14100</b>	4 / 8	3,5 – 4,7 GHz	-	-	12 MB	60 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,50 GHz)
	<b>14100F</b>	4 / 8	3,5 – 4,7 GHz	-	-	12 MB	58 W	DDR4-3200	<b>Nicht vorhanden</b>
	<b>14100T</b>	4 / 8	2,7 – 4,4 GHz	-	-	12 MB	35 W	DDR4-3200	UHD 730 (1,50 GHz)

**K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, T = stromsparend, F = ohne integrierte Grafikkfunktion, TDP = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).**

Hinweise: Das Shuttle XPC slim Barebone DH610S unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

P-Cores: Performance-Cores (leistungsstarke Prozessorkerne), E-Cores: Efficient-Cores (effiziente Prozessorkerne)

Core Clock: es werden Basis- und Turbo-Frequenzen genannt (die Turbo Boost 3.0-Frequenz wird hier nicht genannt)

Base TDF: maximale Prozessor-Verlustleistung, der bei der Basis-Frequenz nicht überschritten wird (Max. Turbo Power wird hier nicht genannt)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter [global.shuttle.com](https://global.shuttle.com).